

MACCHINA PER FINITURA SUPERFICIALE PCB | PROTEC SN BUNGARD



Cod. PROTEC-SN



PROTEC 2030/40 PER LA STAGNATURA DI CIRCUITI STAMPATI

Attrezzatura professionale per il rivestimento superficiale di PCB PROTEC SN Bungard, completa di 5 vasche.
 Esegue il processo di **stagnatura chimica** necessario a prevenire l'ossidazione del rame sulle schede incise.
 La macchina è dotata di tutte le vasche e dell'attrezzatura elettrica necessarie, in un design compatto e funzionale.

Disponibile in due versioni:

- PROTEC 2030**
 Dimensioni massime schede lavorabili: **200x300 mm**
 Elementi riscaldanti in teflon: 2 x 400W
 Volume delle vasche: 10L
 Dimensioni (LxPxH): 790 x 710 x 1160 mm
 Alimentazione: monofase 230V, AC.
- PROTEC 3040**
 Dimensioni massime schede lavorabili: **300x400 mm**
 Elementi riscaldanti in teflon: 2 x 800W



Volume delle vasche: 20L
 Dimensioni (LxPxH): 790 x 810 x 1160 mm
 Alimentazione: monofase 230V, AC.

Dotazione

- **VASCA 1 | Microincisione** - Dotata di valvola di scarico con rubinetto a sfera, coperchio, timer
- **VASCA 2 | Spray/risciacquo** - Regolata da valvola solenoide a sede inclinata, dotata di valvola di scarico con rubinetto a sfera
- **VASCA 3 | Metallo organico** - Dotata di valvola di scarico con rubinetto a sfera, coperchio, timer
- **VASCA 4 | Stagno chimico 7001** - Dotata di elemento riscaldante in PTFE regolato termostaticamente (20-80°C), valvola di scarico con rubinetto a sfera, coperchio, timer
- **VASCA 5 | Risciacquo tiepido** - Dotata di elemento riscaldante in acciaio inossidabile regolato termostaticamente (20-50°C), valvola di scarico con rubinetto a sfera, coperchio, timer
- Telaio in plastica, unità di controllo con interruttore principale
- Supporto per circuiti stampati.

Vantaggi

Uno strato di stagno creato con PROTEC utilizzando il processo Ormecon® offre i seguenti vantaggi:

- Superficie piana per SMD
- Deposito di puro stagno anche con bagni ad elevato carico di rame
- Significativa riduzione della velocità di diffusione
- Possibilità di effettuare saldature multiple, anche con stoccaggio intermedio
- Resistenza termica migliorata.

Il suo speciale design consente di aggiungere o togliere le vasche a seconda delle occorrenze, consentendo ad esempio di effettuare:

- **Nichelatura chimica / Doratura chimica**
- **Rivestimenti OSP** (Organic Solderability Preservative).